

Title (en)
Printed board connector

Title (de)
Leiterplattensteckverbinder

Title (fr)
Connecteur pour une plaque de circuits

Publication
EP 1160922 A2 20011205 (DE)

Application
EP 01112075 A 20010528

Priority
DE 10027556 A 20000602

Abstract (en)
The connector has an insulating housing containing angled contact elements (40) with a plug side (41), a connecting region (44) and a connection side with contact ends (43) for mounting on a circuit board (9). A channel (6) in the insulating housing extends parallel and perpendicular to the surface of the circuit board and is arranged so that the connecting regions of the contact elements protrude into the channel.

Abstract (de)
Für einen kompakten Leiterplattensteckverbinder zur Montage auf einer Leiterplatte, der gleichzeitig mit weiteren elektrischen Bauteilen in einem Umluft-Heizofen mit der Leiterplatte verlötet werden soll, wobei das Lot in Form einer Lotpaste zum Verlöten der Bauteile verwendet wird, wird zur schnellen Erreichung der erforderlichen Löttemperatur an den Lötenden der Kontaktelemente des Leiterplattensteckverbinders vorgeschlagen, bestimmte Kontaktabschnitte der Kontaktelemente, durch innerhalb des Leiterplattensteckverbinders verlaufende Kanäle, mit einem darin zirkulierenden heißen Gasstrom möglichst schnell aufzuheizen. <IMAGE>

IPC 1-7
H01R 12/20; **H01R 12/18**

IPC 8 full level
H01R 12/18 (2006.01); **H01R 12/71** (2011.01); **H01R 12/72** (2011.01); **H01R 13/648** (2006.01); **H01R 43/02** (2006.01); **H05K 3/34** (2006.01)

CPC (source: EP US)
H01R 12/727 (2013.01 - EP US)

Cited by
DE102017218541A1; US10559912B2

Designated contracting state (EPC)
DE FI FR GB SE

DOCDB simple family (publication)
EP 1160922 A2 20011205; **EP 1160922 A3 20030226**; **EP 1160922 B1 20041201**; CA 2349081 A1 20011202; CA 2349081 C 20060718; CN 1142616 C 20040317; CN 1329378 A 20020102; DE 10027556 C1 20011129; DE 50104655 D1 20050105; JP 2002033144 A 20020131; JP 3423700 B2 20030707; US 2001049229 A1 20011206; US 6514103 B2 20030204

DOCDB simple family (application)
EP 01112075 A 20010528; CA 2349081 A 20010530; CN 01119381 A 20010601; DE 10027556 A 20000602; DE 50104655 T 20010528; JP 2001167313 A 20010601; US 86733601 A 20010529